

Title (en)

Method and apparatus for dressing a metal bonded grinding wheel

Title (de)

Verfahren zum Profilieren und Schärfen einer metallisch gebundenen Schleifscheibe und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens

Title (fr)

Dispositif et procédé pour dresser une meule à liaison métal

Publication

EP 1208943 A1 20020529 (DE)

Application

EP 00811112 A 20001122

Priority

EP 00811112 A 20001122

Abstract (en)

The method involves placing an electrode (8) at an adjustable distance from the disc (1), introducing a process liquid into the gap and generating (10) a pulsed voltage between the disc (anode) and electrode (cathode). The electrode is moved towards the disc so that electrochemical treatment of at least one area of disc is performed during a first period of the pulse and at least one area is treated by spark erosion during a second period. Independent claims are also included for the following: an arrangement for implementing the method.

Abstract (de)

Bei einem Verfahren und einer Vorrichtung zum Schärfen und Profilieren einer metallisch gebundenen Schleifscheibe (1), welche zur Bearbeitung von Werkstücken (6) dient, ist eine Elektrode (8) angebracht, die von der Schleifscheibe (1) einen einstellbaren Abstand aufweist. In den so gebildeten Spalt wird eine Prozessflüssigkeit eingebracht. Zwischen der Schleifscheibe (1), welche als Anode dient, und der Elektrode (8), welche als Kathode dient, wird durch einen Generator eine Spannung erzeugt, die die Form von Impulsen aufweist. Die Elektrode (8) wird derart an die Schleifscheibe (1) angenähert, dass mindestens während einem ersten Zeitintervall des Spannungsimpulses mindestens ein Bereich der Schleifscheibe (1) elektrochemisch behandelt wird und während eines zweiten Zeitintervalls des Spannungsimpulses mindestens ein Bereich der Schleifscheibe funkenerosiv behandelt wird. <IMAGE>

IPC 1-7

B24B 53/00

IPC 8 full level

B24B 53/00 (2006.01)

CPC (source: EP)

B24B 53/001 (2013.01)

Citation (search report)

- [X] US 4849599 A 19890718 - KUROMATSU AKIO [JP]
- [DA] EP 0938948 A1 19990901 - RIKAGAKU KENKYUSHO [JP]
- [A] US 4956056 A 19900911 - ZUBATOVA LIDIA S [SU], et al
- [DA] EP 0909611 A1 19990421 - AGATHON AG MASCHF [CH]
- [A] US 5660579 A 19970826 - NAKAYAMA YOSHIRO [JP], et al

Cited by

CN103203688A; EP4169666A1

Designated contracting state (EPC)

CH DE FR GB IT LI

DOCDB simple family (publication)

EP 1208943 A1 20020529

DOCDB simple family (application)

EP 00811112 A 20001122